



技術資料
RM-9802HR2
單液型絕緣接著劑

RM-9802HR2 為環氧樹脂型接著劑，適用於低溫烘烤及低應力之特性。

1. 平滑、流體及無溶劑型之絕緣膠。
2. 中黏度，適用於一般作業方式如沾膠及點膠等。
3. 熱安定性高，300°C 熱重損失低於 0.6 %。
4. 經 100°C 密封萃取後，離子含量低。
5. 絕緣膠品質符合 MIL-STD-883D, Mehtod 5011.3 Type II 規定之品質要求。

產品規格：

黏度	: 16,000~22,000 cps (5 rpm, Brookfield DV-3/CP-51/@25°C)
搖變指數	: 1.5~2.3
標準的烘烤條件	: 150°C / 60 min.
替代的烘烤條件	: 130°C / 90 min.

特性：

晶片接著強度	(11×11 mil die @ 25°C)	> 150 g (Oven Cured@ 150°C / 60min.)
	(80×80 mil die @ 25°C)	> 5 Kg (Oven Cured@ 150°C / 60min.)
體積電阻 @ 25°C		> 1.0×10 ¹⁰ Ω·cm
線性熱膨脹係數	(低於 Tg)	38×10 ⁻⁶ in/in/ °C
	(高於 Tg)	135×10 ⁻⁶ in/in/ °C
TGA 熱重損失	@200°C	0.20 %
	@300°C	0.60 %
玻璃轉移溫度 (Tg)		100°C (DMA PEAK)
使用壽命 @ 25°C (一般環境)		3 天

保存方式：

須冷藏以維持黏度及避免填充物沉澱。啟用前先置室溫解凍後再使用。瓶裝如有分離現象，可輕微攪拌至均勻為止。(須避免空氣進入！)

保存溫度	-40°C	-20°C	-5°C	25°C
保存期限 (密封)	6 個月	5 個月	3 個月	3 天

P.S. 以上資料乃是依據我們對所提供樣品所瞭解之實驗結果而提供的。此資料亦乃是提供使用者於其自行試驗或生產時之參考建議之用。一切之產品試用及實用後結果與其適用與否，最終均取決於試驗單位及使用者之結論與決議。鑒於本公司人員可能未能參與試驗單位或使用者於執行時之討論或作業條件調整，本公司將無法完全保證或負有應用後之一定成果及結果之責任。此建議之內容，亦為建立在非專利保護或違反專利之下所考慮的參考文件。